樹脂材料メーカーのR&D技術者のための

技術専門家セミナー付き技術俯瞰マップ

半導体・先端実装技術シリーズ

（発刊）2026年10月
（体裁）PDF版、動画　※Excelデータ付き
（価格）
専門技術スタッフ解説動画付き：40,000円（税別）
グローバル特許俯瞰版のみ：30,000円（税別）

半導体RDL（再配線層）

半導体の高集積化を支えるRDL技術と材料の進化を俯瞰
技術分類：構造・配線構成／形成・製造プロセス／材料・絶縁、誘電特性／電気・信号、受動素子機能／熱／応力・反り・接着／設計・検査・評価・信頼性
主な出願人：SAMSUNG ELECTRONICS／TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING／SILICON BOX　など

サーマルストレス対策

半導体パッケージの熱応力・反りを抑える技術
技術分類：応力低減・補強構造／封止・アンダーフィル・接着構造／放熱・熱伝導構造／インターポーザ・積層パッケージ構造／配線・ビア・接合技術／応力評価・熱処理・製造制御
主な出願人：TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING／SAMSUNG ELECTRONICS／INTEL　など

TGVガラスインターポーザビア

TGVの形成・充填・界面制御から探る先端実装技術の可能性
技術分類：孔形成・ガラス加工／導電体形成・充填・成膜／界面・熱応力・信頼性制御／TGV構造・配線アーキテクチャ／検査・計測・製造予測／実装・デバイス応用
主な出願人：INTEL／SHYAWEI OPTRONICS／MENLO MICROSYSTEMS／CORNING／JNTC　など

チップレットのポリマー材料

チップレット実装の課題から、新たな材料技術のヒントを探る
技術分類：配線・接合・インターポーザ構造／実装・製造プロセス、仮固定／チップレット集積・パッケージ構造／熱管理・熱応力制御／高周波・光・電源／熱管理・熱応力制御
主な出願人：SAMSUNG ELECTRONICS／TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING／IBM　など

３Ｄポリマー実装

3D実装の課題から探る、ポリマー材料と製造技術
技術分類：3D造形・製造加工／半導体パッケージ・配線接続／電子部品・半導体デバイス構造／樹脂・複合材料／微細加工・機能性薄膜／放熱・冷却技術
主な出願人：CHIPMOS TECHNOLOGIES／ETRON／FUJIAN NORMAL UNIVERSITY／ND HI TECHNOLOGY LAB　など

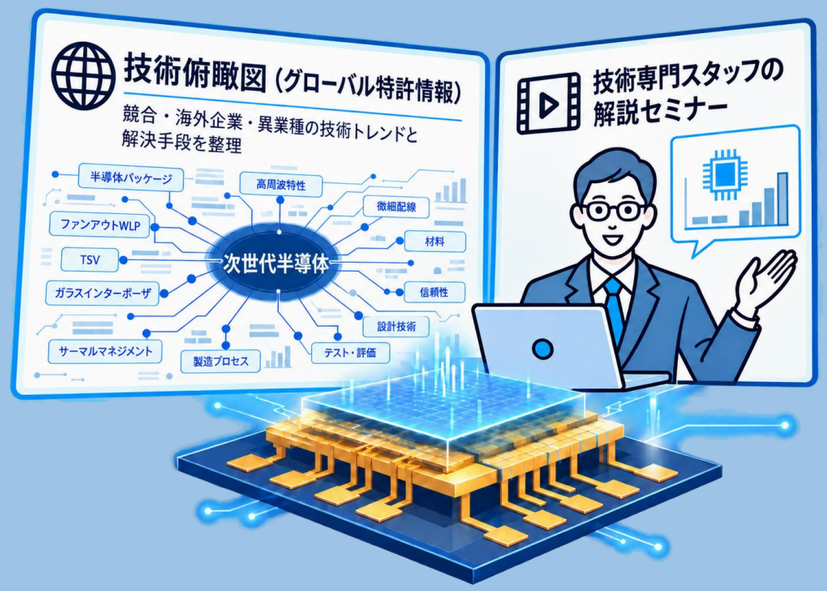
●３か月ごとのアップデート更新サービス
●ご希望技術へフォーカスしたカスタマイズ
●おまとめ割引
など対応いたします！

商品詳細・ご購入はこちら▶
おまとめ割引 10%OFF

株式会社ネオテクノロジー
https://www.neotechnology.co.jp/
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-3-13鈴木ビル2F
TEL：03-3219-0899　MAIL：toiawase@neotechnology.co.jp

樹脂材料メーカーのR&D技術者のための

技術専門家セミナー付き技術俯瞰マップ



半導体・先端実装技術シリーズ

①半導体ＲＤＬ（再配線層）
②サーマルストレス対策
③ＴＧＶガラスインターポーザビア
④チップレットのポリマー材料
⑤３Ｄポリマー実装

2026年10月発刊　各４万円（税別）

半導体市場は、樹脂材料R&Dの新たなチャンス

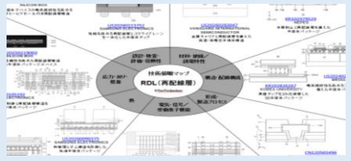


自社材料を、半導体のどこに活かせるか？

世界の特許情報を技術的な観点から整理、研究開発の新たなヒントを提供します。
技術の可能性を広く見渡し、次のアイデアや研究開発テーマの発見につなげます。

技術俯瞰マップ（グローバル特許情報）

競合・海外企業・異業種など、
技術トレンドと解決手段を把握



＋

技術専門スタッフのセミナー

研究開発経験豊富な
技術専門スタッフが、
注目発明を解説します。



・電子材料分野での特許調査実績豊富
・独自の自主特許レポートを発刊

・R&D経験豊富な技術専門スタッフ
・技術と特許に精通した目利き力

特徴

▶注目発明50件をセレクト

技術テーマの見ておきたい特許情報50件をセレクト。

▶技術全体を俯瞰できるガイドマップ

特許情報の多様性で技術を全体俯瞰。

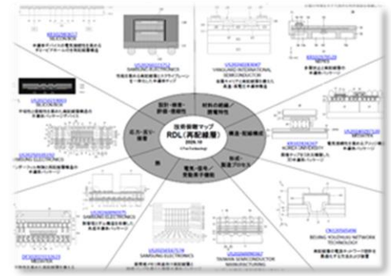
▶技術専門家が動画で解説

注目発明について、技術専門スタッフがポイントを解説。

サービス内容

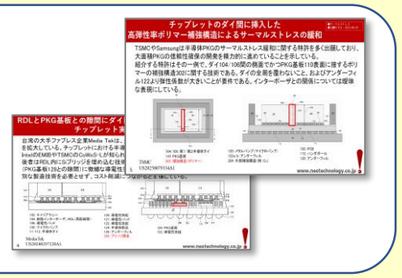
①技術俯瞰マップ

グローバル特許情報を技術的観点で整理し、
技術テーマの全体像を見える化。
自社技術の立ち位置や、注目すべき技術領域を
把握できます。



②特許カード

注目発明を1件ずつカード形式に整理。
発明の技術的特徴や関連する図面で紹介します。
新たな研究開発のヒントとしてお役立てください。



③特許一覧表（Excel）

セレクトした特許情報約50件を一覧化。
技術分類、発明の要点、出願人などの
書誌事項を掲載。
公報リンクから全文明細書をご覧いただけます。

公報リンク	技術分類	要約	出願人
KR1029795	材料・絶縁／誘電	半導体チップを封止層にお	NEPES
US2026014	材料・絶縁／誘電	半導体パッケージモジュー	SAMSUNG ELI
US2026028	材料・絶縁／誘電	基板、半導体層、金属キ	VANGUARD IN
US2025034	材料・絶縁／誘電	ダイパッドを直接覆うニッ	WALTON
CN1209779	構造・配線構成	基板、絶縁パッシベーショ	HUATIAN TEC
CN1206907	構造・配線構成	半導体本体、金属配線層	INNOSCIENCE
US2025011	構造・配線構成	再配線層上の層内にキャ	INTEL
KR1028262	構造・配線構成	メモリチップとASICなど異	KOREA UNIVE

④技術専門家解説セミナー

半導体分野の技術に精通した専門スタッフが、
注目発明の技術的なポイントを約10～15分の
解説動画で紹介。
短時間で技術トレンドや注目発明への理解を
深められます。



シリーズ紹介▶▶▶